

(12) **CERERE DE BREVET DE INVENȚIE CORECTATĂ**

(15) Informația corectată:

Versiunea corectată nr. 1 (W1A2)
Coduri INID, cu text corectat: (71)

(48) Corectură menționată în: BOPI nr. 11 din data 29.11.2012

(21) Nr. cerere: **a 2009 00720**

(22) Data de depozit: **14.09.2009**

(41) Data publicării cererii:

30.03.2011 BOPI Nr. 3/2011

(71) Solicitant:

• UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREȘTI, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR.313, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• MANOLESCU ANTON,
STR. ARH. ȘTEFAN BURCUȘ, NR. 16,
PARTER, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
B, RO;

• MOLDOVAN CARMEN AURA,

BD. ION MIHALACHE, NR. 166, BL. 2,
SC. B, AP. 35, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B,
RO;

• IOSUB RODICA, ȘOS. MIHAI BRAVU,
NR. 42-62, BL. P8, SC.4, ET.8, AP.166,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;

• RADU CORNEL, STR. OLTULUI, NR. 106,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;

• MANOLESCU ANCA MANUELA,
STR. ARH. ȘTEFAN BURCUȘ, NR. 16,
PARTER, AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B,
RO

(54) **PROCEDEU DE REALIZARE A DISPOZITIVELOR ȘI
CIRCUITELOR SEMICONDUCTOARE PE SUBSTRAT
FLEXIBIL**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu pentru obținerea unui dispozitiv semiconductor și a unui circuit pe un substrat flexibil, cu utilizare în realizarea unui senzor, a unei baterii sau a unui alt dispozitiv electric sau electronic, având aplicații diverse, cum ar fi în monitorizarea sportivilor, bolnavilor sau persoanelor cu handicap. Procedeu conform invenției constă în crearea configurației dorite, proiectată și decupată pe un strat flexibil care mai conține un strat transparent, din poliester, inferior, cu ajutorul unui program de calculator, acest substrat fiind în continuare curățat, după care are loc depunere în vid înalt a unui strat metalic subțire, care poate fi constituit dintr-un aliaj de Cr-Au, cu o grosime de 200 nm, apoi este îndepărtat materialul metalic din părțile nedorite, prin exfolierea stratului colorat superior, care acționează ca un strat de mascare, depunerea metalică rămânând în zonele transparente definind geometria

unui dispozitiv, ca și cea a traseelor conductoare de interconectare, iar în continuare are loc depunerea electrochimică a polianilinei dintr-o soluție acidă.

Revendicări: 8

Figuri: 7

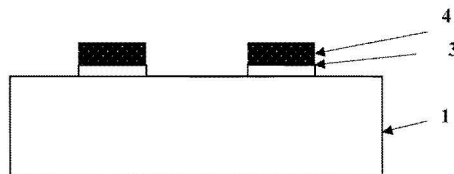


Fig. 5

